



TIC™800G系列 是一種高性能低熔點相變化導熱界面材料。在溫度50°C，TIC™800G開始軟化並流動，填充散熱片和積體電路板的接觸介面上細微不規則間隙，以達到減小熱阻的目的。TIC™800G系列在室溫下呈可彎曲固態，無需增強材料而獨立使用，免除了增強材料對熱傳導性能的影響。而在工作溫度下，其中相變材料軟化的同時又不會完全液化或溢出。

最小熱阻系列:

- 》 0.014°C-in²/W 熱阻
- 》 室溫下具有天然黏性, 無需黏合劑
- 》 流动性好, 但不会像导热膏

应用

- 》 笔记本电脑和台式电脑
- 》 机顶盒
- 》 内存模块
- 》 热管散热解决方案

TIC800G 系列特性表

產品名稱	TIC805G	TIC808G	TIC810G	TIC816G	Test Method
顏色	灰色				目視
厚度	0.005" (0.127mm)	0.008" (0.203mm)	0.010" (0.254mm)	0.016" (0.4mm)	ASTM D374
密度	2.5g/cc				氮氣比重瓶
工作溫度	- 25 °C ~ 125 °C				*****
相變化溫度	50 °C ~ 60 °C				*****
熱傳導率	5.0W/mk				ASTM D5470 (修正)
熱阻抗 @ 50 psi	0.014°C-in ² /W	0.020°C-in ² /W	0.038°C-in ² /W	0.045°C-in ² /W	ASTM D5470 (修正)

標準厚度:

0.005"(0.127mm) 0.008"(0.203mm) 0.010"(0.254mm) 0.016"(0.4mm)

如需不同厚度請與本公司聯繫。

標準尺寸:

10" x 16"(254mm x 406mm) 16" X 400' (406mm X 121.92M) TIC™800G 系列片料供應時附有白色離型紙及底襯墊，模切半斷加工可提供拉手,也可提供模切成單個形狀型試提供。

壓敏黏合劑:

壓敏黏合劑不適用於TIC™ 800G系列產品。

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网：<http://www.ziitek.com>



导热灌封胶 | 相变化材料 | 导热矽胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热硅胶片 | 陶瓷散热片 | 石墨片 | 导热塑料

加拿大:

Tel: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

台灣:

Tel: +886-2-22771007
Fax: +886-2-22771075
E-mail: jerry@ziitek.com.tw

东莞:

Tel: +86-769-38801208
Fax: +86-769-83791290
E-mail: angus@ziitek.com

昆山:

Tel: +86-512-57816297
Fax: +86-512-57816327
E-mail: kelvin@ziitek.com

成都:

Tel: +86-28-62379168
Fax: +86-28-62379168
E-mail: david_cd@ziitek.com